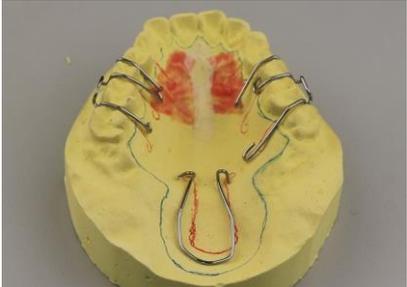


文件名稱	機能裝置製作	章節	第二章	文件編號	002
		版本/次	1	頁次	1

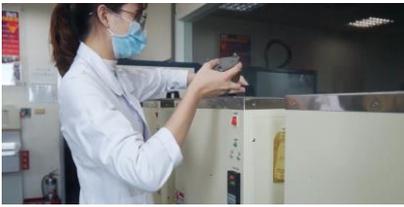
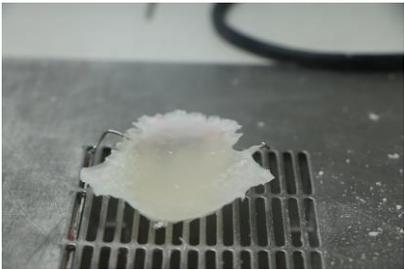
PAP/PLP 固位修復體-牙床底板與升腭板 製作

步驟圖片	步驟流程	步驟標準
 	基底床範圍析量	<ol style="list-style-type: none"> 1. 量測上顎底板的範圍，以藍色蠟鉛筆畫出樹脂床區域 2. 以紅色蠟鉛筆畫出牙鉤位置，分別為臼齒區的 1 個 adam 氏卡環，以及小白齒區的 1 個 c 形卡環 3. 依據醫師指示，將後顎板範圍以藍色蠟鉛筆繪製出來 4. 連接底板處，以紅色鉛筆繪製 0.9mm wire 線串聯主體
	顎皺壁(Rugae)緩壓	將上顎的顎皺壁(Rugae)進行緩壓(relief)
 	彎製牙鉤	選定 0.9mm wire 線彎製 Adam's 牙鉤、C 形卡環及連結後腭板的 wire 線，並於牙齒區固定

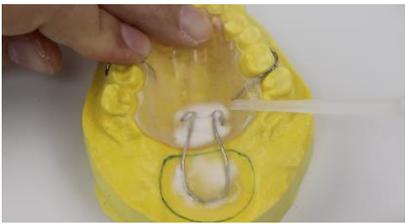
文件名稱	機能裝置製作	章節	第二章	文件編號	002
		版本/次	1	頁次	2

	<p>製作牙床(1)</p>	<p>熱固性樹脂： 先以三級蠟製作基底床並將 wire 線的腳部，固定於基板中</p>
	<p>包埋與加熱去蠟</p>	<p>將模型進行包埋(Flasking)→第一層普通石膏→露出蠟板與樹脂牙→調整模型高度→灌入第二層硬石膏 加熱→去除三級蠟→並將殘餘蠟用沖洗式去除</p>

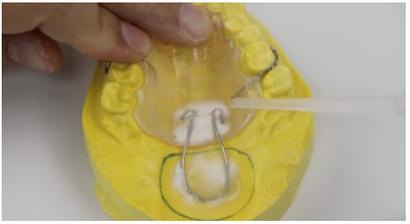
文件名稱	機能裝置製作	章節	第二章	文件編號	002
		版本/次	1	頁次	3

	<p>填入樹脂</p>	<p>於團狀期填入樹脂(聚甲基丙烯酸甲酯)</p>
	<p>樹脂聚合</p>	<p>將煮聚盒放入加熱槽進行煮聚，分兩階段： 1. 於 74°C 下 8 小時 2. 再於 100°C 中 1 小時</p>
	<p>製作牙床(2)</p>	<p>自凝性樹脂： a. 先將 wire 線固定 b. 將樹脂粉均勻(厚度 2-3mm)鋪放於繪製好之牙床範圍內，依序增加厚度，再以單體小心浸潤使其固化 c. 完成後，置入裝有熱水的壓力鍋內使其聚合 d. 取出成品</p>
	<p>調整外觀</p>	<p>去除包埋盒取區成品 將模型取下後修整邊緣或有礙於戴入路徑的多餘樹脂</p>

文件名稱	機能裝置製作	章節	第二章	文件編號	002
		版本/次	1	頁次	4

		
 	<p>研磨/打亮</p>	<p>使用鑽針從粗研磨到細研磨，最後用白土進行表面拋光打亮</p> <p>備註：組織面切記不可研磨，以避免影響精確與密合度</p>
 	<p>試戴</p>	<p>交還牙醫師進行試戴調整，並搭配發音與左右側方運動，看升腭裝置與腭增強裝置需要那些調整或加厚</p>
	<p>製作後腭板與舌頭</p>	<p>將後顎板於軟顎區以蠟片依照繪製範圍製作出來，</p> <p>另以三級蠟製作舌頭</p>

文件名稱	機能裝置製作	章節	第二章	文件編號	002
		版本/次	1	頁次	5

		
 	<p>後腭板結合到主裝置</p>	<p>將先前的 wire 鉤與軟顎連接線固定於主要模型上</p> <p>進行聚合→研磨→打亮</p>
	<p>舌頭結合到主裝置</p>	
	<p>完成</p>	